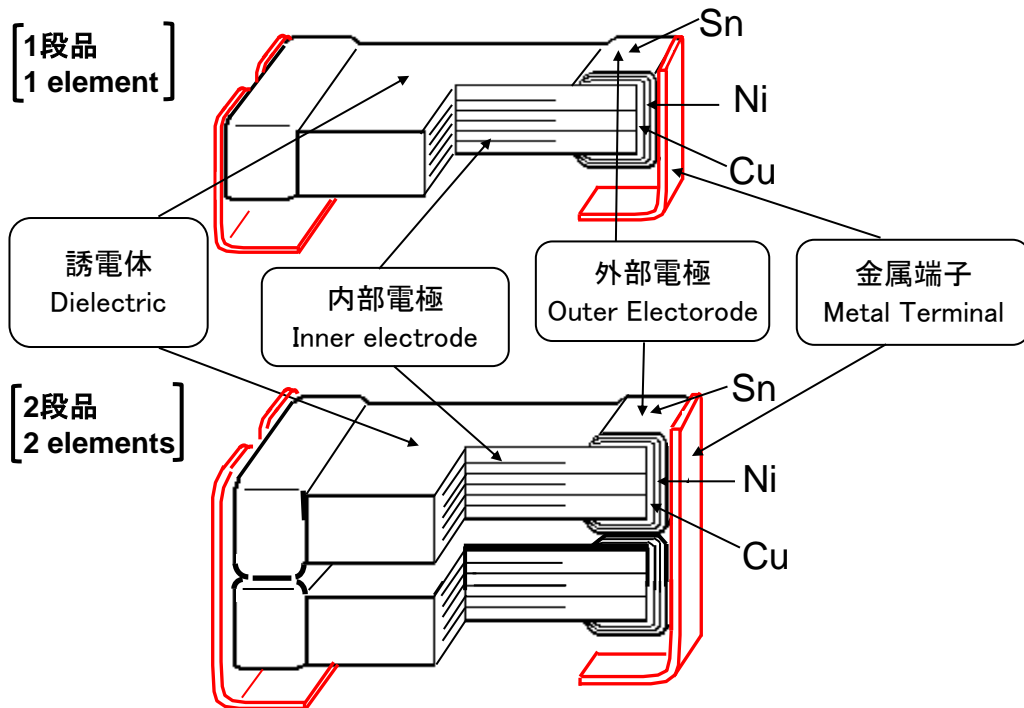


構造図 STRUCTURE and MATERIAL

金属端子タイプ積層セラミックコンデンサ

Metal Terminal Type Multilayer Ceramic Capacitors

< KR* Series / KC* Series >



構成表 CONSTRUCTION

項目 ITEM		材質 MATERIAL	
チップ積層 セラミック コンデンサ Chip Multilayer Ceramic Capacitor	誘電体 Dielectric	セラミック Ceramic	
	内部電極 Inner electrode	Ni	
	外部電極 Outer Electrode	第1層 base layer	Cu
		第2層 2nd layer	Ni
最外層 outer layer		Sn	
金属端子 Metal Terminal		鉄系合金(Ni/Snめっき)または リン青銅(Ni/Snめっき) Ferric alloy (Ni/Sn plating) or Phosphor bronze(Ni/Sn plating)	
金属端子接合材 Joint material of metal terminal and outer electrode of chip capacitor		Sn-Ag-Cu系はんだまたは Sn-Sb系はんだ Sn-Ag-Cu solder or Sn-Sb solder	